

公司概況資料表

以下資料由台灣精材股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

認購相關資訊

公司簡介

風險事項說明(申請登錄戰略新三板公司適用)

主要業務項目

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

最近五年度簡明資產負債表

最近三年度財務比率

公司名稱：台灣精材股份有限公司 (股票代號：3467)

申請登錄：一般板 戰略新三板

董事長	馬堅勇
總經理	王元星
資本額	新台幣282,065,690元
輔導推薦證券商	元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	元大證券股份有限公司 陳思帆(07)215-1698 分機613
註冊地國	(外國發行人適用)
訴訟及非訟代理人	(外國發行人適用)

輔導推薦證券商認購台灣精材股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦
-------	----	----

	元大證券	凱基證券															
認購日期	112/12/18																
認購股數(股)	750,000	100,000															
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	2.66%	0.35%															
認購價格	35元																
認購價格之訂定依據及方式	<p>目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：</p> <p>(1)市場法：本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)及股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。</p> <p>(2)成本法：係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。</p> <p>(3)現金流量折現法：採用未來現金流量作為公司價值之評定基礎。</p> <p>以上股票評價方法，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反映資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握；股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或成熟產業但獲利波動劇烈的景氣循環公司，而該公司屬獲利穩定之產業，故本推薦證券商僅就本益比法作為評估基準。</p> <p>台灣精材股份有限公司(以下簡稱台灣精材或該公司)主要從事半導體設備關鍵零組件之製造與銷售，產品種類包含精密陶瓷、石英及矽環等產品，主係用於半導體前段製程(蝕刻製程與薄膜製程)設備，主要客戶為國際半導體設備大廠、半導體耗材代理商及晶圓代工廠。經參考國內已上市櫃從事半導體設備零組件公司之同業資料，選擇業務型態、產品性質、公司規模及營業項目較為相近者作為採樣同業：(1)瑞耘(上櫃公司，股票代號6532)主要營業項目為半導體製程設備及零組件(2)意德士科技(上櫃公司，股票代7556)主要營業項目為半導體生產製程中所使用之精密零組件、材料與製程次系統的製造、銷售、維修與技術服務(3)中砂(上市公司，股票代號1560)主要營業項目為主要從事生產及銷售砂輪、半導體鑽石碟、再生晶圓等研磨工具(4)翔名(上櫃公司，股票代號8091)主要營業項目為半導體前段製程之材料、設備及關鍵零組件之製造、買賣及維修。</p> <p>茲彙總採樣同業最近三個月(112年9月~11月)之平均本益比如下：</p> <p style="text-align: right;">單位：倍</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>採樣同業</th> <th>112年 9月</th> <th>112年 10月</th> <th>112年 11月</th> <th>平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>瑞耘</td> <td>14.30</td> <td>14.56</td> <td>16.47</td> <td>15.11</td> </tr> <tr> <td>意德士科技</td> <td>18.34</td> <td>18.17</td> <td>22.73</td> <td>19.75</td> </tr> </tbody> </table>		採樣同業	112年 9月	112年 10月	112年 11月	平均	瑞耘	14.30	14.56	16.47	15.11	意德士科技	18.34	18.17	22.73	19.75
採樣同業	112年 9月	112年 10月	112年 11月	平均													
瑞耘	14.30	14.56	16.47	15.11													
意德士科技	18.34	18.17	22.73	19.75													

中砂	23.55	26.47	29.97	26.66
翔名	10.33	10.48	13.84	11.55
上市股票-半導體業	14.61	15.08	18.27	15.99
上櫃股票-半導體業	21.52	22.20	28.32	24.01

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站

由上表得知，採樣同業及上櫃半導體業類股最近三個月(112年9月~112年11月)之平均本益比約介於11.55~26.66倍之間；另依據該公司最近四季(111年下半年度~112年上半年度)經會計師查核簽證或核閱之財務報告列示之稅後淨利，以截至目前為止已發行股份總數28,206,569股設算，計算之每股盈餘為1.43元，按上述本益比區間計算其參考價格，其參考價格區間約為16.52~38.12元，故主辦及協辦推薦證券商股票認購價格為每股35元，介於合理價格區間內，認購價格尚屬合理。

綜上所述，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之各項評價法計算台灣精材之合理價格，並考量該公司之經營績效、獲利情形、所處市場環境、產業未來成長性，由本推薦證券商與該公司共同議定之興櫃認購價格，尚屬合理。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹

台灣精材股份有限公司成立於民國86年9月，主要產品為半導體前段蝕刻及薄膜製程設備所使用的關鍵零組件，依材質區分主要為陶瓷、石英、矽三大類產品。公司的產品主要應用在半導體薄膜沉積及蝕刻製程，由於精密陶瓷零組件是放在離晶圓相對接近的真空腔體內，因此必須具備高強度、耐高溫、耐高壓、耐電漿、抗腐蝕、高精度、組織均勻等要求，台灣精材透過漿料混練、噴霧造粒、冷壓成型、生胚加工、燒結、清洗等一條龍式的生產，以其關鍵的燒結及自主清洗等關鍵製造技術，可降低陶瓷材料製作/開發之成本與風險，技術已達到晶圓代工大廠先進製程要求，並獲得國際半導體設備大廠認證合格，為台灣少數可以提供半導體等級陶瓷材料之企業。截至112/11/30止實收資本額為新臺幣282,066千元。

二、歷史沿革

日期	重要發展記事
民國 86年9月	於竹北成立啟成實業，資本額為新臺幣1,000千元。
民國 89年11月	現金增資25,000千元，累計實收資本額為26,000千元。
民國 90年2月	變更公司名稱為啟成科技股份有限公司。
民國90年7月	現金增資20,000千元，累計實收資本額為46,000千元。
民國 90年11月	現金增資30,000千元，盈餘轉增資21,594千元，累計實收資本額為97,594千元。

民國 91年04月	現金增資45,606千元，盈餘轉增資36,800千元，累計實收資本額為180,000千元。
民國 91年10月	於湖口工業區設立材料研發中心及加工生產線。
民國 92年12月	現金增資30,000千元、盈餘轉增資3,600千元及資本公積轉增資18,000千元，累計實收資本額231,600千元。
民國 93年6月	取得 ISO 9001:2000 & 14001:2004 證書。
民國93年9月	辦理股票公開發行。
民國 93年11月	長安新廠動土。
民國 93年11月	盈餘轉增資18,400千元及資本公積轉增資10,000千元，合計增資28,400千元，累計實收資本額為260,000千元。
民國 94年03月	現金增資30,000千元、資本公積轉增資26,000千元及債權抵繳股款70,000千元，累計實收資本額為386,000千元。
民國 94年12月	新廠正式啟用。 主要以半導體製程設備，如蝕刻(etch)、薄膜(deposition)等製程設備所需之零件之研發、製造與銷售為主要業務。
民國95年1月	撤銷股票公開發行。
民國 95年12月	現金增資50,000千元，累計實收資本額為436,000千元。
民國 96年1月	現金增資50,000千元，累計實收資本額為486,000千元。
民國 96年5月	取得 OHSAS 18001:1999證書。
民國 98年5月	光洋科集團投資入主。
民國 98年5月	減資36,643千股，減少實收資本額366,428千元，減資後實收資本額為119,572千元。
民國 98年6月	現金增資150,000千元，累計實收資本額為269,572千元。
民國 98年10月	正式更名為台灣精材股份有限公司。
民國 99年10月	成為國際半導體設備大廠全球合格供應商。
民國 101年4月	成功發展產品預加工近形技術及 as fired 技術並開始量產陶瓷 Dome 類 (ceramic domes) 關鍵產品。
民國 102年2月	核心技術正式獲得國際半導體設備大廠認證合格： 1.高純度氧化鋁陶瓷材料 Sicalox998。 2.超高真空零組件(UHV component)加工製造技術。 3.零件清洗技術。
民國 102年12月	減資減少11,839千股，減少實收資本額118,387千元，減資後實收資本額為151,185千元。 現金增資30,000千元，增資後實收資本額為181,185千元。
民國 103年7月	開發國際大廠正式簽約合作，進入半導體設備大廠的專業代工領域。
民國105年11月	榮剛集團投資。
民國 106年1月	取得 ISO 9001:2015 & 14001:2015 證書。
民國 106年10月	取得 OHSAS 18001:2007證書。
民國 107年12月	現金增資50,000千元，增資後實收資本額為231,185千元。
民國 108年7月	盈餘轉增資6,920千元，增資後實收資本額為238,105千元。
民國108年10月	開始生產並供貨 N7/N5 產品。
民國 109年10月	取得 ISO 45001:2018證書。
民國109年11月	建置完成更高純度氧化鋁材料 FA998生產線，並獲得國際半導體設備大廠認證通過。

民國110年1月	成功開發300mm ceramic domes 並開始大量生產供貨。
民國 110年7月	成為國際先進半導體大廠战略合作夥伴，研發先進、次世代技術與材料。
民國 110年7月	成功開發陶瓷零件再生(part refurbishment)技術，獲得國際半導體設備大廠測試認證通過。
民國112年1月	榮剛集團於112年1月轉讓出售其本公司之全部持股後，不具董事身分
民國112年4月	光洋應用材料科技(股)公司於112年4月轉讓出售其本公司之全部持股後，不具董事身分
民國 112年6月	員工認股權行使6,150千元，增資後實收資本額為244,255千元。
民國 112年7月	盈餘轉增資29,311千元，增資後實收資本額為273,566千元。
民國112年8月	員工認股權行使8,500千元，增資後實收資本額為282,066千元。

三、經營理念

台灣精材專注於本業之經營，重視技術之研發及業務行銷之拓展，建立以人才為本、成果共享、永續經營的企業經營理念，並專注於整合技術能力，以提供客戶高品質的服務及產品，與供應商及客戶一同成長。

四、未來展望

(1)短期業務發展計畫

- A.市場開拓：持續深耕與國際半導體大廠战略合作夥伴關係，開拓新商機，提高市場占有率。
- B.產品與技術研發策略：將舊產品及成熟產品去蕪存菁，並持續開發先進製程技術與高階產品，擴大高階製品的占比，優化產品組合並提高毛利率。
- C.人力資源：持續培養、引進優秀的技術與管理人才，建立高效能團隊(high performance team)，為公司永續經營成長目標，奠定重要基礎。
- D.生產管理：落實精實生產，降低成本，建立全員參與、持續改善的公司文化。
- E.財務績效：提升風險管控能力，維持健康的現金流和財務流動性，建立可長可久，穩定獲利的營運模式。

(2)長期業務發展計畫

- A.上下游重直整合(vertical integration)：產品與技術在現有的優勢基礎上延伸，開發新材料、新商業模式，開創新商機，最終的目標是建立一個無縫、嚴密的整合平台，提供客戶一站式的整體解決方案(one-stop total solutions)。
- B.產品線擴展(line extension)：由現有產品優勢為基礎，開拓新市場、新產品、新商機。

風險事項說明(登錄戰略新板公司適用)

非申請登錄戰略新板，故不適用

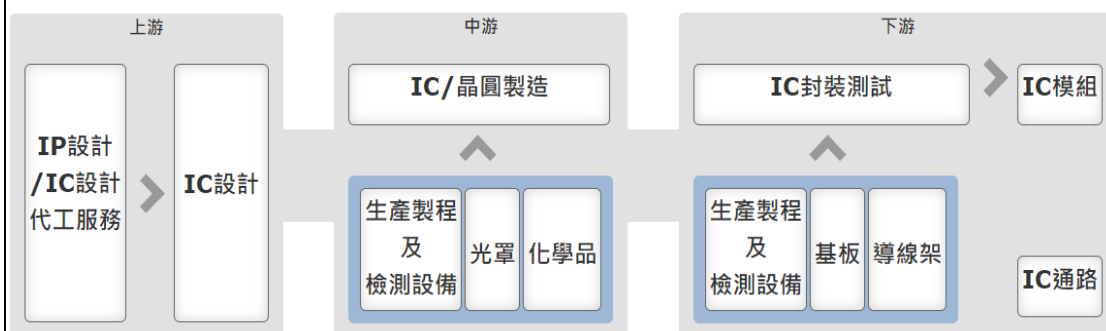
主要業務項目：

主要係從事半導體前段製程(蝕刻製程及薄膜製程)設備所使用的關鍵零組件耗材之製造及銷售，嚴選國內外高品質符合半導體等級材料，透過精密加工製造跟零件清洗完成製作，提供客戶標準品與客製化產品。依材質區分主要為陶瓷、石英、矽三大類產品。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：










半導體產業主要由上游 IC 設計廠商開始發展，接著中游 IC 製造、晶圓製造及相關製程與檢測設備等廠商相互配合及分工，將晶圓廠做好的晶圓，以光罩印上電路基本圖樣，再依靠各工段之製程設備，如氧化、擴散、蝕刻、沉積及離子植入等方法，將電路及電路上的元件，在晶圓上製作出來。該公司為半導體製程設備耗材製造商，即為中游廠商。最後，由下游廠商進行 IC 封裝，即將晶圓切割後的晶粒，用塑膠、陶瓷或金屬包覆，藉以保護晶粒免受碰撞及污染，且易於裝配，並達成晶片與電子系統的電性連接與散熱效果。

茲將其上、中、下游關聯性列示如下：



資料來源：產業價值鏈資訊平台

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度營收金額(千元)	佔總營收比重(%)
精密陶瓷 (Ceramic)		<ol style="list-style-type: none"> 使用於薄膜(thin film deposition)製程真空腔體，面對製程中電漿腐蝕及化學反應能有效的保護腔體環境。 在電漿蝕刻腔體中能阻擋電漿蝕刻嚴酷的腐蝕環境，同時順利傳輸射頻(radio frequency)及微波(microwave)能量。 用於控制精準的氣流分布，讓氣體在蝕刻製程腔體中能均勻的分布，這類製品需要優異的抗電漿腐蝕及介電強度特性。 真空腔體中使用各種設計的陶瓷環，其主要目的是用來保護晶圓及其周邊物件。 	444,526	68.21

	 			
	 			
石英製品 (Quartz)	  	<p>在需要頻繁進行高溫處理和化學處理的半導體製造過程中，無論在晶圓薄膜生成和擴散過程中，或是在運輸及洗淨工程中，需要使用高純度的由石英玻璃組成的石英製品。</p>	148,165	22.73
矽製品 (Silicon)	 	<p>大量的矽環製品使用於蝕刻設備腔體，其接近於零缺陷的材料特性，加上與晶圓相同的電性特性 (electrical properties)，讓電漿蝕刻作業控制更精準。</p>	59,037	9.06
合計			651,728	100.00

TOP ^

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	107年	108年	109年	110年	111年	112年截至10月份止 (自結數)(註2)
營業收入		539,308	471,730	458,285	564,799	651,728	468,125
營業毛利		67,931	69,905	62,449	76,359	106,511	77,901
毛利率(%)		12.60	14.82	13.36	13.52	16.34	16.64
營業外收入		33,125	13,720	4,632	4,326	16,744	10,170
營業外支出		(7,690)	(9,499)	(7,735)	(6,956)	(8,270)	(5,932)
稅前損益		39,689	21,181	6,605	15,832	42,571	21,328
稅後損益		38,695	21,173	6,605	15,832	47,942	21,328
每股盈餘(元)		2.03	0.89	0.28	0.66	2.01	0.77
股利發放	現金股利(元)	0.70	0.30	0.25	0.50	—	尚未分配
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	—	—	—	—	—	

股票股利(盈餘轉增資)(元)	0.30	—	—	—	1.20
----------------	------	---	---	---	------

註1：各年度財務資料係依 IFRSs 編製並經會計師查核簽證。

註2：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度		107年	108年	109年	110年	111年
項目						
流動資產		333,613	237,447	245,966	337,062	343,643
基金及長期投資		—	—	—	—	—
固定資產		392,781	388,570	345,331	331,395	348,813
無形資產		—	—	—	—	—
其他資產		16,753	12,033	19,610	7,466	19,937
資產總額		743,147	638,050	610,907	675,923	712,393
流動負債	分配前	221,937	138,041	110,216	197,219	207,227
	分配後	238,085	145,169	116,168	209,124	207,227
長期負債		177,889	151,663	152,141	120,274	109,346
其他負債		—	—	—	—	—
負債總額	分配前	399,826	289,704	262,357	317,493	316,573
	分配後	415,974	296,832	268,309	329,398	316,573
股本		231,185	238,105	238,105	238,105	238,105
資本公積		50,210	50,210	50,437	50,437	51,790
保留盈餘	分配前	62,426	60,531	60,008	69,888	105,925
	分配後	39,358	53,403	54,056	57,983	76,614
長期股權投資		—	—	—	—	—
未實現跌價損失		—	—	—	—	—
累積換算調整數		—	—	—	—	—
庫藏股票		(500)	(500)	—	—	—
股東權益總額	分配前	343,321	348,346	348,550	358,430	395,820
	分配後	327,173	341,218	342,598	346,525	395,820

註1：各年度財務資料係依 IFRSs 編製並經會計師查核簽證。

TOP ^

最近三年度財務比率

年度		109年	110年	111年
項目				
財務比率	毛利率(%)	13.36	13.52	16.34
	流動比率(%)	223.17	170.91	165.83
	應收帳款天數(天)	48	48	46
	存貨週轉天數(天)	127	109	102
	負債比率(%)	42.95	46.97	44.44

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站](#)!!